

Ref. No. OH003761

Dispatch No.574598

Dispatch Date: November 13, 2007

Official Notification of Reason for Refusal

Patent Application No.: 2002-325771

Drafting Date: November 7, 2007

Examiner of JPO: Masataka SHIBAYAMA 3035 4M00

Representative / Applicant: Takashi OHGAKI

Applied Provision: Patent Law Section 29(2)

[Final Rejection]

This application should be refused for the reason mentioned below. If the applicant has any argument against the reason, such argument should be submitted within 60 days from the date of this notification.

Reason(s)

1. The invention(s) in the claim(s) mentioned below of the subject application should not be granted a patent under Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made by persons who have common knowledge in the technical field to which the invention(s) pertains, on the basis of the invention(s) described in the publications mentioned below which were distributed in Japan or foreign countries, or the invention(s) made usable by the public via electric communication lines prior to the filing of the subject application.

Note (See the list of cited documents etc., below.)

[Claims 1, 2]

- Reason 1
- Cited Documents 1-2, 3-6
- Remarks

Refer to Figures 1-3 and explanation thereof in the description of the cited document 1.

Refer to Figures 1-5 and explanation thereof in the description of the cited document 2.

Connecting a wiring pattern to the pads, providing post portions on the wiring pattern, providing external terminals on the post portions, and providing a sealing layer on the wiring pattern and on the side face of the post portions so that the top faces of the post portions are exposed, are common general technical knowledge. (Refer to cited documents 3-6, if necessary.) The applying of this technology to the inventions disclosed in the cited documents 1 and 2 could have easily made by a person skilled in the art.

In the cited document 3, it is described that an oxidation film is formed on the surface of the post portions.

[The list of cited documents]

1. JP 9-199701 A
2. JP 2001-298050 A
3. JP 2000-323510 A
4. JP 2001-144204 A
5. JP 9-0640^y89 A
6. JP 2000-353762 A

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 3 2 5 7 7 1
起案日	平成 1 9 年 1 1 月 7 日
特許庁審査官	柴山 将隆 3 0 3 5 4 M 0 0
特許出願人代理人	大垣 孝 様
適用条文	第 2 9 条第 2 項

<<<< 最 後 >>>>

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出してください。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

[請求項 1, 2]

- ・理由 1
- ・引用文献 1 - 2, 3 - 6
- ・備考

引用文献 1 の図 1 - 3 及びその説明箇所参照。

引用文献 2 の図 1 - 5 及びその説明箇所参照。

パッドに配線パターンを接続し、配線パターン上にポスト部を設けポスト上に外部端子を設けること、ポスト部の頂面を露出するように配線パターン上及びポスト部側面に封止層を設けることは周知技術にすぎない（必要ならば、引用文献 3 - 6 を参照されたい）。この技術を引用文献 1 又は 2 に記載の発明に採用することは当業者が容易に成し得ることである。

また、引用文献 3 には、ポスト部の表面に酸化膜を形成する旨の記載がある。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平09-199701号公報
2. 特開2001-298050号公報
3. 特開2000-323510号公報
4. 特開2001-144204号公報
5. 特開平09-064049号公報
6. 特開2000-353762号公報

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

審査第三部 半導体機器 審査官 柴山将隆

TEL. 03(3581)1101 内線3462

FAX. 03(3501)0673

最後の拒絶理由通知とする理由

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。